

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-002

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

# 关于拟投建集成电路材料华东制造基地项目 并签署相关投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟投建项目名称：**艾森集成电路材料华东制造基地项目（项目名称暂定）
- 项目实施主体：**公司拟设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司（暂定名，以工商核名为准，以下简称“艾森芯材”）作为项目实施主体。
- 项目投资金额：**预计项目投资总额 20 亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
- 项目时间安排：**项目分两期建设，一期预计 2028 年投产；二期预计 2030 年投产。整体项目预计于 2035 年达产。
- 审议程序：**本次投资相关事宜已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。**

### 相关风险提示：

- 政策风险：**本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立项、环评等行政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设，尚需市场监管部门注册批准，审批结果存在一定不确定性。公司将持续关注国家与地方产业政策动向，降低因政策环境变化可能导致的项目延期、变更及中止风险。
- 资金筹措风险：**本项目投资金额较大，资金来源包括自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式，相关资金筹措存在一定不确定性。公司将强化资金统筹与现金流管理，保障资金供给稳定。

- **收益不达预期风险：**本项目建成后，每年相应的固定资产折旧费用将增加，若项目管理不善或产品市场开拓不力，可能导致不能如期产生效益或实际收益低于规划目标。公司将通过分期投入、模块化建设、持续优化产品布局及工艺等方式，提升项目盈利能力和抗风险水平。

综上，本次投资存在相关风险，涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，存在不确定性，亦不构成对投资者的承诺。针对上述风险，公司将依托自身积累的技术及产业经验与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本次投资的安全性与收益性。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

根据江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略布局及经营发展的需要，加快推进产能布局的落地实施，更有效配合市场需求，完善产业布局，公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目，并与南通市经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议。

预计项目投资总额为人民币 20 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），总规划土地约 159 亩（具体以土地使用权出让合同为准），建设年产 23,000 吨集成电路材料生产线。项目分两期建设，规划产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。资金来源为公司自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式。

### （二）对外投资的审批程序

公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意公司在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目

目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

前述事项尚需提交公司股东会审议。

### （三）不属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

## 二、合作方基本情况

名称：南通市经济技术开发区管理委员会

关联关系说明：公司与南通市经济技术开发区管理委员会不存在关联关系

## 三、实施主体基本情况

本投资项目拟由公司新设子公司艾森芯材实施，相关情况如下：

公司名称	南通艾森芯材科技有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	沈鑫
注册资本	20,000 万元
注册地址	南通市经济技术开发区
股权结构	江苏艾森半导体材料股份有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

## **四、投资协议主要内容**

### **(一) 签署主体**

甲方：南通市经济技术开发区管理委员会

乙方：江苏艾森半导体材料股份有限公司

### **(二) 项目概况**

#### **1、项目内容：**

乙方拟在南通市经济技术开发区获取项目用地，并建设“艾森集成电路材料华东制造基地”项目，建设年产 23,000 吨集成电路材料生产线。产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。

#### **2、项目投资：**

项目计划总投资人民币 20 亿元，其中固定资产投资约人民币 17 亿元（设备投资约人民币 12 亿元）。

#### **3、项目用地位置、面积：**

乙方拟按法定流程取得项目用地。项目地块位于南通市经济技术开发区江河路南、通达路东。项目总规划约 159 亩。具体以土地使用权出让合同为准。

#### **4、新设项目实施主体：**

乙方于 2026 年 3 月底前在南通市经济技术开发区注册成立项目新公司作为项目运营主体（以下简称“新公司”），新公司注册资本 2 亿元，以现金出资，自新公司注册成立之日起六个月内到账不低于 3,000 万元，自新公司注册成立之日起 5 年内缴足全部注册资本。

#### **5、项目进程：**

一期项目在取得项目用地使用权后 3 个月内开工建设，于开工后 15 个月内竣工，2028 年投产；二期项目在一期项目竣工后 6 个月内开工建设，于开工后 12 个月内竣工，2030 年投产。整体项目于 2035 年达产。非因乙方原因造成项目进程延误的，双方另行协商后续安排。

#### **6、项目支持：**

在完成项目相关的审批/备案程序的前提下，项目设定相应的销售收入及税收指标。同时，为鼓励项目发展，甲方根据相关政策文件精神，为乙方及新公司在满足条件时申报各类扶持政策等提供支持和协助（各类扶持政策的审核标准及兑现流程等以最新政策文件为准）。

相关扶持、奖励等措施，均以乙方及新公司完成协议约定义务（包括但不限于项目投资、项目进程、项目指标、经营期限等）为前提。如因乙方或新公司自身原因导致项目后期经营状况出现较大差距的，应立即主动整改。如经甲方催告仍未采取合理有效的整改措施的，或经整改仍无法改善经营状况、完成各项义务的，甲方有权对已兑现及未兑现各项扶持、奖励等措施进行调减、收回，乙方及新公司有义务予以配合。

## 7、各方权利义务

### 1) 甲方的主要权利义务

甲方积极协助乙方办理新公司注册、项目报建以及项目建设运营过程中的相关手续。甲方积极协助乙方完成项目用地挂牌出让程序并配合乙方依法办理相关手续。土地使用相关事宜以乙方另行签订的土地使用权出让合同及土地交付合同为准。

### 2) 乙方及新公司的主要权利义务

(1) 乙方按时完成资本注册、资金投入，积极推进项目建设，乙方及新公司对甲方提供的扶持、奖励等措施，全部安排使用于本项目建设，并确保项目按期开工建设、投产运营、达产达效，完成项目指标。

(2) 乙方承诺，将在南通开发区设立光刻胶研发中心。

(3) 乙方项目在南通开发区经营期限不少于 20 年，乙方根据发展情况拟增资、减资的，与甲方协商一致后依法依规办理。

## 8、协议终止

如公司未能根据双方约定取得项目用地，则本协议终止，双方无需就本协议的终止向对方承担违约责任。如公司在本协议签署之日起 3 个月内未就本项目进行项目备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估，或上述备案（或核准）和评估之一不能通过有关部门批准的，双方可就项目进程进行另行协商顺延。

## 9、协议生效

本协议自双方正式授权代表签署并加盖公章之日起生效。

## 五、本次对外投资的必要性及对公司的影响

基于公司整体战略布局及经营发展的需要，围绕公司目前的客户和市场结构，为加快推进产能布局的快速落地，完善产业布局，并推动公司业务的合理、适当延伸，公司拟投资建设集成电路材料华东制造基地项目。本项目拟在南通市经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。该制造基地建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司光刻胶、电镀液及配套试剂等高端电子化学品未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，考虑到本次投资采取购地新建厂房的方式实施，存在较长的施工建设等准备周期，短期内不会对公司财务状况及业绩带来重大收益。

## 六、本次投资的主要风险分析

**政策风险：**本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立项、环评等行政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设，尚需市场监管部门注册批准，审批结果存在一定不确定性。公司将持续关注国家与地方产业政策动向，降低因政策环境变化可能导致的项目延期、变更及中止风险。

**资金筹措风险：**本项目投资金额较大，资金来源包括自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式，相关资金筹措存在一定不确定性。公司将强化资金统筹与现金流管理，保障资金供给稳定。

**收益不达预期风险：**本项目建成后，每年相应的固定资产折旧费用将增加，若项目管理不善或产品市场开拓不力，可能导致不能如期产生效益或实际收益低于规划目标。公司将通过分期投入、模块化建设、持续优化产品布局及工艺等方式，提升项目盈利能力和抗风险水平。

综上，本次投资存在相关风险，涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，存在不确定性，亦不构成对投资者的承诺。针对上述风险，公司将依托自身积累的技术及产业经验与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本次投资的安全性与收益性。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年1月28日